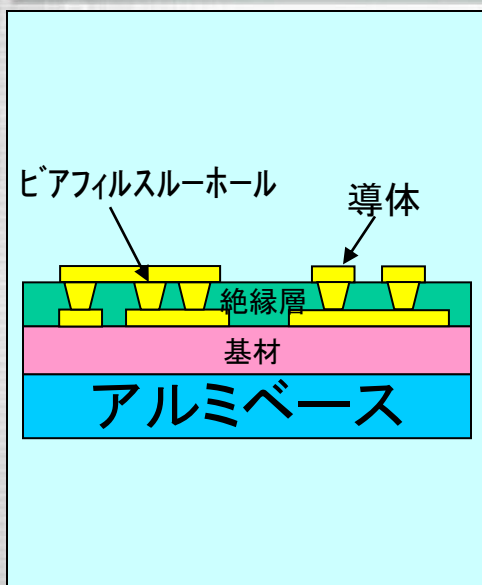


片面ビルドアップ メタルベースプリント配線板

片面2層アルミベースプリント配線板



■パワーモジュール向け プリント配線板

<層構成>

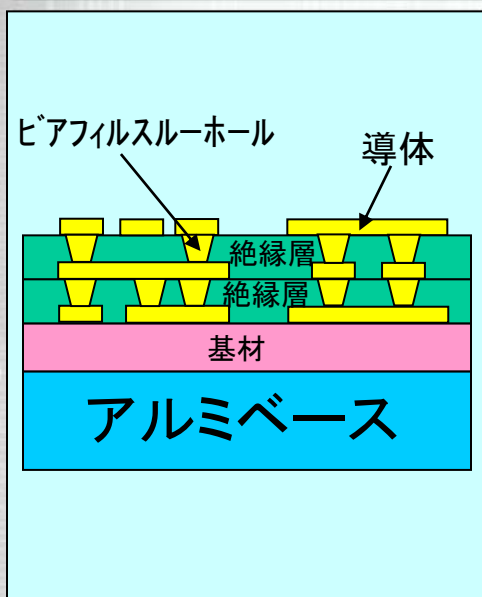
基 材...AC-7200TY
熱伝導率5.0W/mK(利昌工業(株)製)

絶縁層...AD-7200TY
熱伝導率5.0W/mK(利昌工業(株)製)

アルミ...0.5, 1.0, 1.5, 2.0mm

※ビルドアップ工法による
高放熱・高密度パターンが
可能になりました

片面3層アルミベースプリント配線板



※高放熱材料の組み合わせで
熱抵抗値の低減に成功

※様々な層構成の対応が可能です

cgk

株式会社ちの技研

ISO9001
認 証

ISO14001
認 証